

BGA 3500DX

紅外線 BGA返修系統(加大型)

BGA / SMD Rework System

專業 · 精準 · 穩定 · 高效

專為電子表面黏著元件返修設計，
結合紅外線加熱、溫度閉環控制、
RPC回流焊接製程監控及精密光學對位功能，
協助使用者掌握返修過程中的溫度變化
與晶片定位，滿足BGA/SMD零件
拆焊與焊接需求。

 紅外線
加熱系統

 閉環
溫度控制

 RPC
製程監控

 PL 精密
光學對位



01 上下紅外線加熱系統



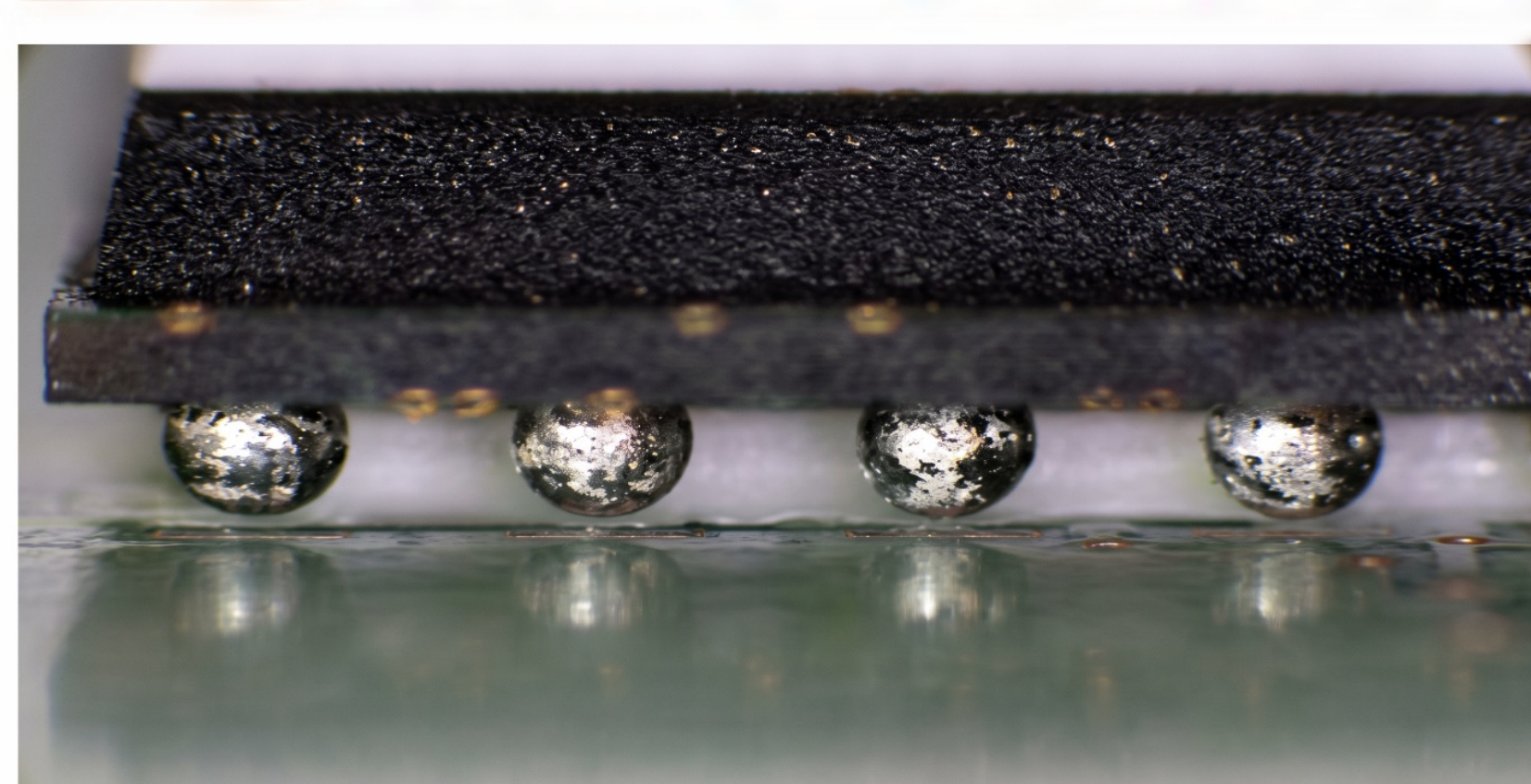
總功率最高6,200W，
底部 4,500W / 頂部 1,700W，
溫度均勻、加熱穩定。

02 閉環溫度控制



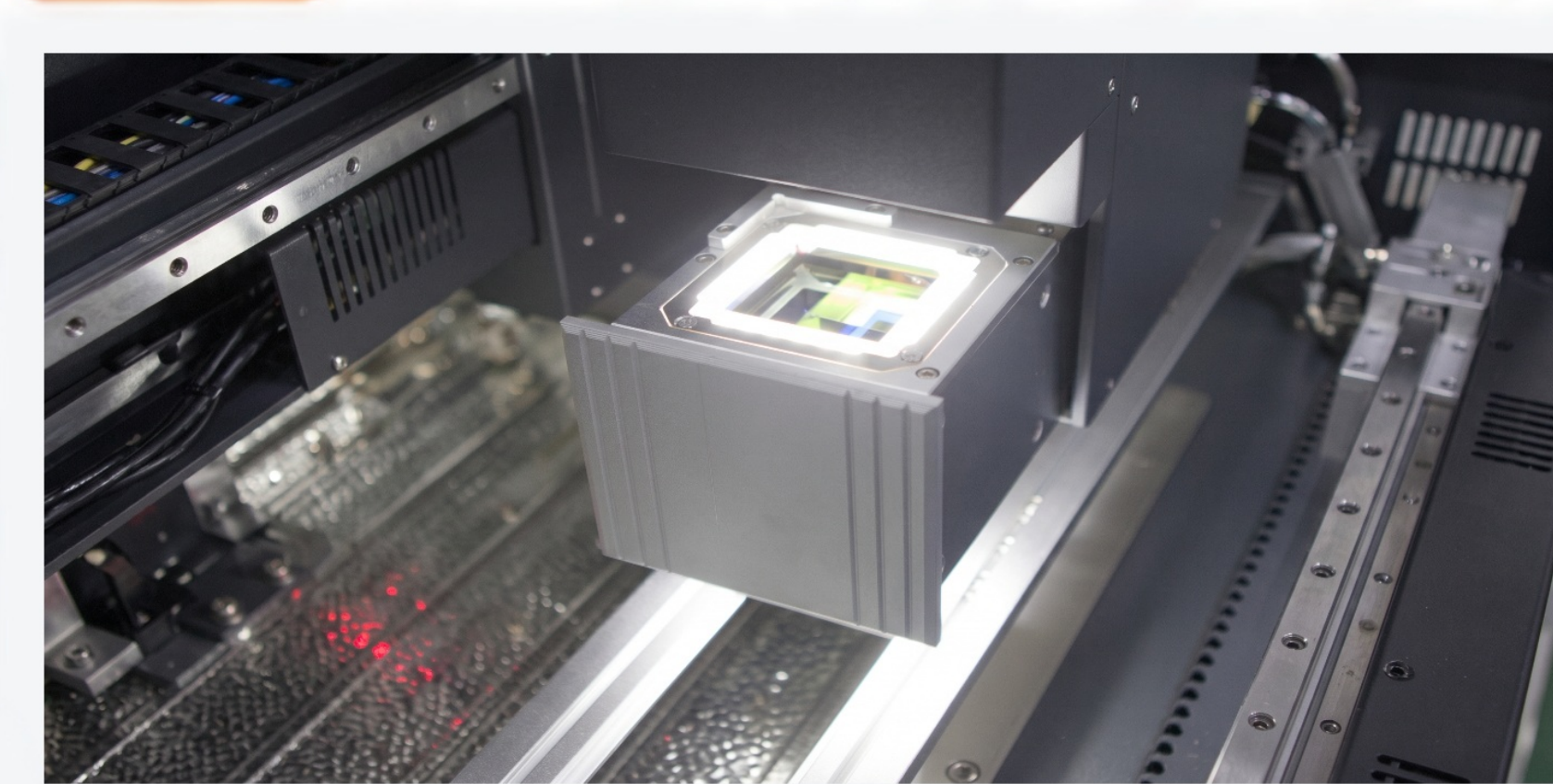
非接觸式紅外線測溫，
即時監測晶片溫度，
可設定加熱流程，
精準控制返修製程。

03 RPC溶錫監控系統



透過RPC攝影機觀察
焊點溶化狀態，
輔助判斷拆焊與焊接過程。

04 PL 精密光學對位



238萬像素攝影機，
30倍光學、12 倍數位放大，
協助晶片與 PCB 焊點
精準對位。

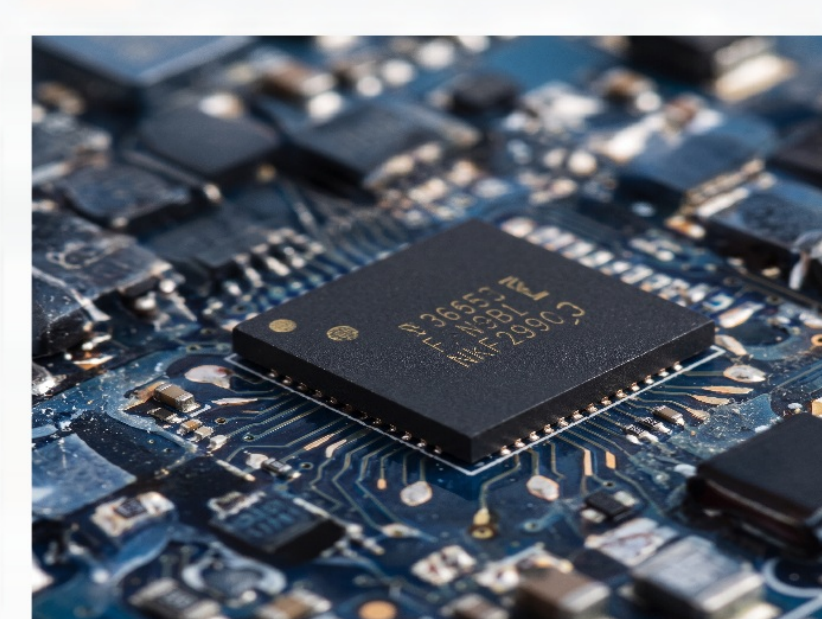
產品規格

SPECIFICATIONS

紅外線加熱總功率	6,200 W (Max)
底部預熱功率	500W x9 = 4,500 W (紅外發熱管)
頂部加熱功率	170Wx10=1,700 W (紅外發熱管)
最大線路板尺寸	700x680 mm
頂部加熱器尺寸	90 x 90 mm
PL菱鏡尺寸	80 X 80 mm
紅外線測溫範圍	0~300°C
外接K型傳感器	3通道
PL攝影機有效像素	238萬像素
PL 攝影機放大倍率	30倍光學、12 倍
PL 影像解析度	1920 x 1080P
PL 對位Y軸行程	100mm
吸桿貼放Z軸行程	180mm
整機淨重	180kg

應用領域

APPLICATIONS



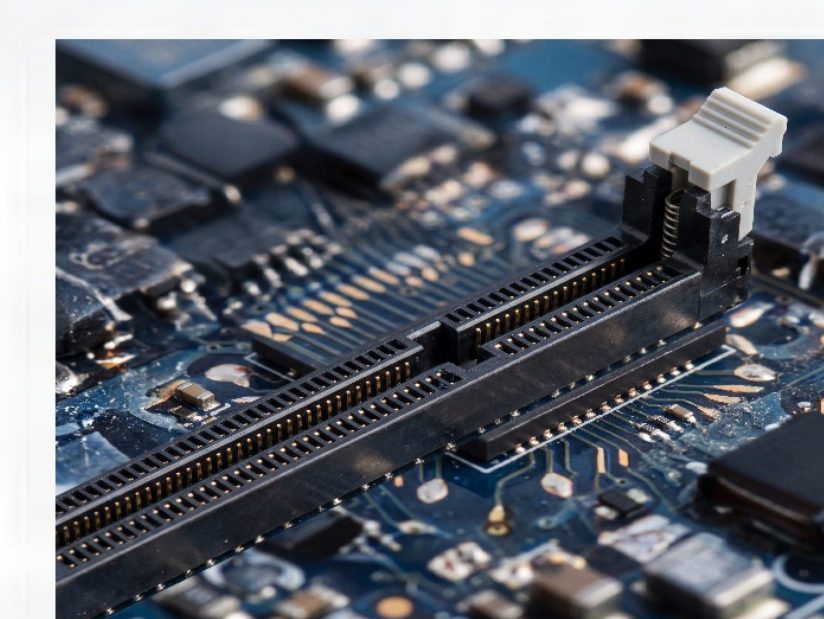
QFN 元件拆焊



BGA 零件焊接



QFP 零件返修



DIMM卡槽維修

VECTECH 威鐵克

承邦有限公司

Chen Bom Trading Co.,Ltd.

02-8647-2988

新北市汐止區大同路三段190號8樓

www.cbtrade.com.tw



掃描進入官網

高精度返修
創造更高良率

PRECISION
REWORK
HIGH YIELD